

成績稽核

教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
開課系所	機械與自動化工程學系	無參考教科書	班級	四技部3年2班
任課教師	王東安	專兼任別	兼任	

參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
無參考教材及專業期刊導讀				

課程簡介

上課進度

週次	教學內容	講授	示範	習作	實驗	其他
1	Open view	60	20	20		
2	Bulk micromachining	60	20	20		
3	Surface micromachining	60	20	20		
4	Scaling of forces	60	20	20		
5	Microstructural elements	60	20	20		
6	EXAM I	60	20	20		
7	Energy methods	60	20	20		
8	Electrostatic actuators	60	20	20		
9	LIGA(微光刻電鍍模造): Capacitive position sensing	60	20	20		
10	Process integration	60	20	20		
11	Microfluidics	60	20	20		
12	EXAM II	60	20	20		
13	Lab on a chip	60	20	20		
14	Wafer bonding and packaging	60	20	20		
15	Assembly techniques for MEMS	60	20	20		
16	Presentation	60	20	20		
17	No class	0	0	0		
18	Final exam	60	20	20		

課程與系所基本素養及核心能力之關連

教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
--------	--------------	--------------	------	---------------	---------------------	---------------------------

無此教學
計畫表資
訊!

